

Thementage Digitale Bild- und Volumenkorrelation 30.09. – 01.10.2024

Bitte melden Sie sich für diese Veranstaltung unter www.cwm-chemnitz.de an!

Tag 1 30.09.2024 Chair: Susanne Vinke/Bettina Seiler

Zeit	Referent	Firma/Einrichtung	Vortragstitel
13:00	Bettina Seiler	Chemnitzer Werkstoffmechanik GmbH	Begrüßung
13:10	Bettina Seiler	Chemnitzer Werkstoffmechanik GmbH	30 Jahre Digitale Bildkorrelation in Chemnitz
13:30	Dr. Rainer Dudek	Fraunhofer ENAS	Validierung thermo-mechanischer FE-Analysen von Elektronikaufbauten mittels Bildkorrelation in Mikrobereichen
13:50	Ingrid Maus	Infineon Technologies AG Regensburg	Anwendung der Digitalen Bildkorrelation (DIC) zur Deformationsmessung von Wafer Level Package - Aufbauten auf Leiterplatte
14:10	Lutz Scheiter	Chemnitzer Werkstoffmechanik GmbH	microDAC®- Einsatz in der thermo-mechanischen Material- und Bauteilanalyse
14:40	Pause		
15:20	Bernhard Sartory	Materials Center Leoben	Limits und Herausforderungen der digitalen Bild-Korrelation zur Bestimmung von Eigenspannungen und Dehnungslokalisationen in der Werkstoffwissenschaft
15:40	Susana Richter-Trommer	Fraunhofer ENAS	DIC in REM-Anwendungen am Fraunhofer ENAS
16:00	Dr. Anja Weidner	TU Bergakademie Freiberg	Lokale Spannungs- und Dehnungsfelder in Formgedächtnislegierungen
16:20	Dieter Swoboda	Kammrath & Weiss GmbH	Mikrobelastungstechnik für REM und Workbenchsysteme
16:40	Dr. Christina Burkhardt	TU Bergakademie Freiberg	Ermittlung der lokalen Dehnungsverteilung an additiv gefertigten Gitterstrukturen mittels DIC
19:00	Gemeinsames Abendessen in der Ratsstube Chemnitz		

Tag 2 01.10.2024 Chair: Ralf Döring/Susanne Vinke

Zeit	Referent	Firma/Einrichtung	Vortragstitel
9:00	Prof. Sven Rzepka	Fraunhofer ENAS	Begrüßung
9:10	Elke Noack	Fraunhofer ENAS	Wissenswertes zur Anwendung Digitaler Volumenkorrelation (DVC)
9:30	Dagmar Nestler	Chemnitzer Werkstoffmechanik GmbH	DVC-Software VEDDAC volume zur Charakterisierung biomechanischer Eigenschaften von Knochen und 3D-gedruckten Knochenersatzmaterialien
10:00	Pause		
10:30	Brinda George	Infineon Technologies AG Neubiberg	Rissmodellierung in Halbleiter- Packagematerialien mittels Simulation und Digitaler Bildkorrelation
10:50	Marcus Schulz	Berliner Nanotest und Design GmbH	VEDDAC Risspitzen-Detektion im AMB Delaminationstest
11:10	Carl Wolf	TU Bergakademie Freiberg	Bestimmung von Spannungsintensitätsfaktoren mittels Digitaler Bildkorrelation
11:30	Felix Weigand	Chemnitzer Werkstoffmechanik GmbH	VEDDAC py für die skriptgesteuerte & automatisierbare DIC-Analyse
11:50	Lisa Kreher	Fraunhofer ENAS	Einsatz von microDAC® und VEDDAC in den Laboren des Fraunhofer ENAS
12:00	ENAS - Laborführung		

Ende gegen 13.00 Uhr

Stand 01.08.2024